



CV5386 CV5401

SMDモジュール用 低反り液状封止材

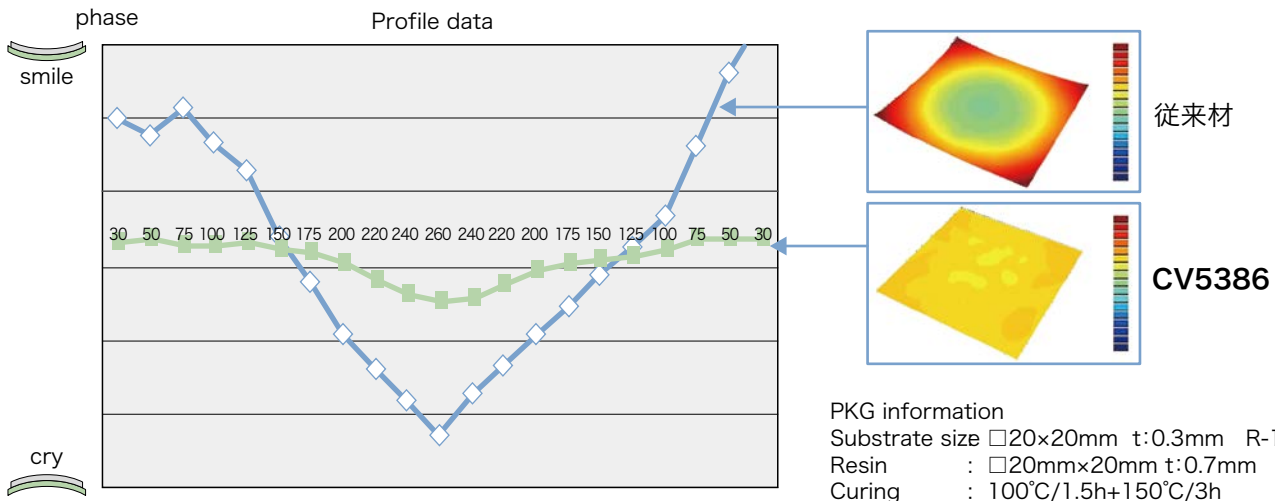
実装リフロー時の半田フラッシュを抑制し、不良率を大幅低減します。超薄型モジュールの低反り化を実現。大面積封止が可能。

用途

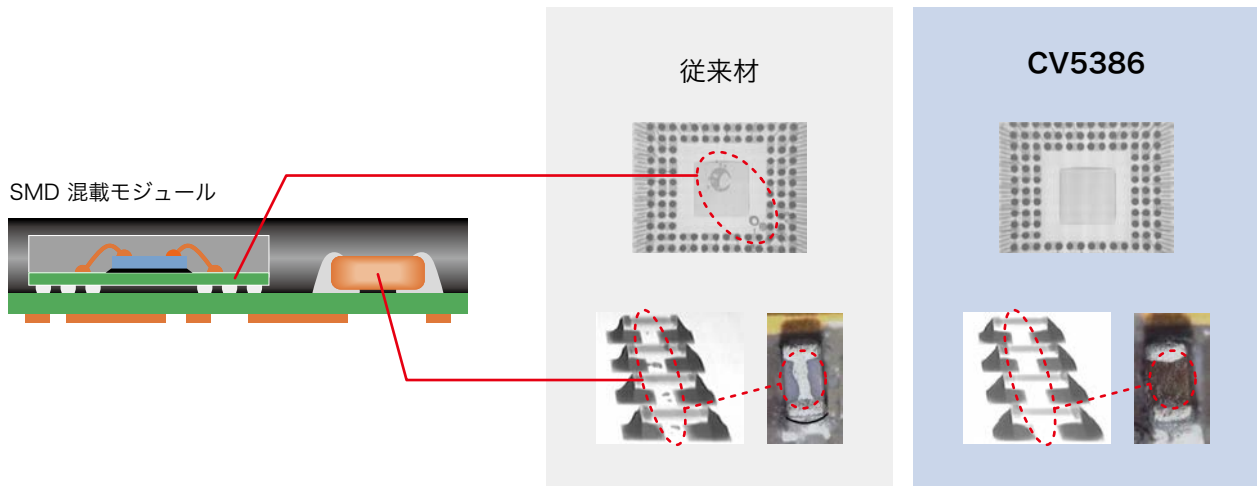
半導体パッケージ/モバイル

ノートPC、デジカメ、携帯電話、スマートフォン、タブレットPC用通信モジュール (MAP、COB)

反り挙動：シャドウモアレ解析



実装リフロー後の半田フラッシュ(X線観察)



商品のご採用にあたっては、当社webサイトより注意事項をご確認ください。

industrial.panasonic.com/jp/electronic-materials

Panasonic Industry CV5386